

证券代码：688375

证券简称：国博电子

南京国博电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	天风证券、华夏基金、昊泽致远、中信证券、金百镨投资、中信建投基金、广发基金、国投证券、华福证券、富国基金、海通资管、富安达基金、宁泉资产、国投瑞银、泰信基金、申万宏源、国海富兰克林、汇丰晋信、方圆金鼎、上银基金、崇山投资、五聚资产、安联基金、南华基金、兴银理财、大朴资产、招商基金、汉石私募、恒泰证券、光大证券
时间	2025年2月12日-2月13日
地点	北京、上海
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 刘洋 证券事务代表 魏兴尧 投资者关系 李蓝天
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问公司2024年的T/R组件收入有多少？以及在各应用平台的收入如何拆分？</p> <p>T/R组件领域，公司凭借在微波毫米波设计领域的技术优势和制造工艺的长期积累，在各应用平台都取得相关进展。由于保密原因，有关T/R组件产品的具体信息不便披露，具体收入情况请关注公司后续披露的定期报告。</p> <p>2、请介绍一下公司射频芯片产品的基本情况？</p> <p>国博电子射频芯片主要包括射频放大类芯片、射频控制类芯片，广泛应用于移动通信基站等通信系统。在移动通信基站和终端领域，公司开发完成WiFi、手机PA等射频放大类芯片</p>

产品，性能达到国内先进水平，同时正在进行基于新型半导体工艺的新产品研发；在射频控制类芯片方面，公司应用于终端的射频开关、天线调谐器产品量产，多个射频开关被客户引入并批量交付，DiFEM 相关芯片量产交付，产品性能达到国内先进水平。公司基站射频芯片开发紧跟市场需求，针对 5G-A 通感基站应用，进行产品的性能优化，产品规格达到国际领先水平。

3、2024 年公司在低轨卫星领域的产品收入情况如何？

国博电子主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售，其中 T/R 组件是低轨卫星载荷平台的核心之一，在卫星载荷中价值占比较高。公司在低轨卫星和商业航天领域均开展了技术研发和产品开发工作，多款 T/R 组件产品已交付客户。在射频集成电路领域，公司已开展卫星通信领域多个射频集成电路的技术研发和产品开发工作，多款产品已被客户引入。具体销售收入情况请关注公司后续披露的定期报告。

4、公司 T/R 组件的 T/R 芯片是来自哪里？

公司拥有自己专业的芯片研发设计团队，自主研发的 GaN 射频芯片已在 T/R 组件中得到广泛的工程应用，T/R 组件产品的芯片制造主要依托于五十五所完成。

5、在芯片领域，公司和 55 所是否具有一定的业务重叠？

根据公司招股说明书披露，中国电科五十五所主要从事固态器件和微系统、光电显示与探测器件研发、生产和销售。其固态器件中的微波毫米波芯片和公司射频芯片存在一定的相似度。但中国电科五十五所主要从事微波毫米波芯片的设计和制造，产品主要用于特种行业市场，而国博电子主要从事射频芯片的设计，产品主要用于民用通信领域。二者在具体产品性能、形态、产业链环节、应用领域、主要客户等方面均存在较大差异，且双方的核心技术均来源于自身技术研发和积累、技

术来源独立。因此不构成同业竞争。

6、公司募投项目的主要建设目的是什么？

随着有源相控阵产品迭代升级和移动通信技术发展，射频电子的应用领域更加广泛，公司需要持续加强科技创新实力和产业化能力，不断提高产品质量和生产效率，提升核心竞争能力，争取更多的市场应用。公司募投项目射频芯片和组件产业化项目将进一步升级研发射频芯片、模块和 T/R 组件领域相关技术，重点实现毫米波和太赫兹 T/R 组件设计技术能力、工艺制造技术能力、测试能力、可靠性评估等能力的进一步提升，实现移动通信射频芯片和微波毫米波芯片设计研发、在片测试能力提升。募投项目能够提高微波毫米波相关技术水平，是提升公司核心产品产业化能力的必经之路，有助于公司迎接未来市场需求升级的挑战，满足日益增加的市场需求。通过项目的实施，将为公司高质量发展奠定坚实的基础。

7、公司是否有资产注入的计划？

公司未来如有资本运作相关计划，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

8、公司 2025 年的业绩如何展望？

受到行业部分因素以及订单节奏的影响，公司业绩短期承压。公司将继续聚焦主营业务发展，坚持科技创新驱动发展战略，深化精益制造管理理念，不断加强研发能力、提高产品质量以及提升生产效率，进一步增强公司盈利能力和竞争实力，努力回报社会和广大投资者。

9、公司应用于手机的卫星通信 PA 目前进展如何？

公司重视并积极开拓终端领域，正在进行基于新型半导体工艺的新产品研发，具体情况涉及商业秘密且未在披露范围内，请持续关注公司后续披露的相关公告。

10、公司在 T/R 组件领域的竞争对手有哪些？

根据公司招股说明书，T/R 组件领域选定的可比公司为雷

	<p>电微力和火箭科技。</p> <p>11、公司在星网公司项目的参与程度如何？</p> <p>公司在低轨卫星和商业航天领域均开展了技术研发和产品开发工作，多款 T/R 组件产品已交付客户。具体情况涉及商业秘密，请持续关注公司后续披露的相关公告。</p> <p>12、公司各业务领域的毛利率分别是什么水平？</p> <p>公司主营业务毛利率保持在一个稳定的区间内，总体呈稳中有升态势。</p> <p>13、公司预计 2025 年在手机终端侧的产品应用情况如何？</p> <p>公司重视并积极开拓终端领域，多款终端用射频芯片产品已经开始向业内知名终端厂商批量供货。公司将持续加大研发投入，不断提升产品的性能和质量以满足市场需求，逐步提高手机终端产品的出货量。</p> <p>14、公司近期是否有股权激励的计划？</p> <p>公司如有相关计划，将严格按照规定履行信息披露义务。</p>
附件清单(如有)	无
是否涉及应当披露重大信息	否
日期	2025 年 2 月 17 日